

2019年中国IC（半导体）市场分析报告- 行业运营态势与发展前景预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国IC（半导体）市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/456118456118.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国半导体材料产业运行环境分析

第一节 2016-2019年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡家庭人均可支配收入
- 三、恩格尔系数
- 四、中国城镇化率
- 五、存贷款利率变化
- 六、财政收支状况

第二节 2016-2019年中国半导体材料产业政策环境分析

- 一、《电子信息产业调整和振兴规划》
- 二、新政策对半导体材料业有积极作用
- 三、进出口政策分析

第三节 2016-2019年中国半导体材料产业社会环境分析

第二章 2016-2019年半导体材料发展基本概述

第一节 主要半导体材料概况

- 一、半导体材料简述
- 二、半导体材料的种类
- 三、半导体材料的制备

第二节 其他半导体材料的概况

- 一、非晶半导体材料概况
- 二、GaN材料的特性与应用
- 三、可印式氧化物半导体材料技术发展

第三章 2016-2019年世界半导体材料产业运行形势综述

第一节 2016-2019年全球总体市场发展分析

- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、亚太地区的半导体出货量受金融危机影响较小
- 四、模拟IC遭受重挫，无线下滑幅度最小

第二节 2016-2019年主要国家或地区半导体材料行业发展新动态分析

- 一、比利时半导体材料行业调研
- 二、德国半导体材料行业调研
- 三、日本半导体材料行业调研
- 四、韩国半导体材料行业调研
- 五、中国台湾半导体材料行业调研

第四章 2016-2019年中国半导体材料行业运行动态分析

第一节 2016-2019年中国半导体材料行业发展概述

- 一、全球代工将形成两强的新格局
- 二、应加强与中国本地制造商合作
- 三、电子材料业对半导体材料行业的影响

第二节 2016-2019年半导体材料行业企业动态

- 一、元器件企业增势强劲
- 二、应用材料企业进军封装

第三节 2016-2019年中国半导体材料发展存在问题分析

第五章 2016-2019年中国半导体材料行业技术分析

第一节 2016-2019年半导体材料行业技术现状分析

- 一、硅太阳能技术占主导
- 二、产业呼唤政策扩大内需

第二节 2016-2019年半导体材料行业技术动态分析

- 一、功率半导体技术动态
- 二、闪光驱动器技术动态
- 三、封装技术动态
- 四、太阳光电系统技术动态

第三节 2019-2025年半导体材料行业技术前景分析

第六章 2016-2019年中国半导体材料氮化镓产业运行分析

第一节 2016-2019年中国第三代半导体材料相关介绍

- 一、第三代半导体材料的发展历程
- 二、当前半导体材料的研究热点和趋势
- 三、宽禁带半导体材料

第二节 2016-2019年中国氮化镓的发展概况

- 一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
- 二、氮化镓照亮半导体照明产业

三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节 2016-2019年中国氮化镓的研发和应用状况

- 一、中科院研制成功氮化镓基激光器
- 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
- 三、非极性氮化镓材料的研究有进展
- 四、氮化镓的应用范围

第七章 2016-2019年中国其他半导体材料运行局势分析

第一节 砷化镓

- 一、砷化镓单晶材料国际发展概况
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓研究状况
- 四、宽禁带氮化镓材料

第二节 碳化硅

- 一、半导体硅材料介绍
- 二、多晶硅
- 三、单晶硅和外延片
- 四、高温碳化硅

第八章 2016-2019年中国半导体分立器件制造业主要指标监测分析

第一节 2016-2019年中国半导体分立器件制造行业数据监测回顾

- 一、竞争企业数量
- 二、亏损面情况
- 三、市场销售额增长
- 四、利润总额增长
- 五、投资资产增长性
- 六、行业从业人数调查分析

第二节 2016-2019年中国半导体分立器件制造行业投资价值测算

- 一、销售利润率
- 二、销售毛利率
- 三、资产利润率
- 四、未来5年半导体分立器件制造盈利能力预测

第三节 2016-2019年中国半导体分立器件制造行业产销率调查

- 一、工业总产值
- 二、工业销售产值

三、产销率调查

第九章 2016-2019年中国半导体市场供需分析

第一节 LED产业发展

- 一、国外LED产业发展情况分析
- 二、国内LED产业发展情况分析
- 三、LED产业所面临的问题分析
- 四、2019-2025年LED产业发展趋势及前景分析

第二节 集成电路

- 一、中国集成电路销售情况分析
- 二、集成电路及微电子组件（8542）进出口数据分析
- 三、集成电路产量统计分析

第三节 电子元器件

- 一、电子元器件的发展特点分析
- 二、电子元件产量分析
- 三、电子元器件的趋势分析

第四节 半导体分立器件

- 一、半导体分立器件市场发展特点分析
- 二、半导体分立器件产量分析
- 三、半导体分立器件发展趋势分析

第十章 2016-2019年中国半导体材料行业市场竞争格局分析

第一节 2016-2019年欧洲半导体材料行业竞争分析

第二节 2016-2019年我国半导体材料市场竞争分析

- 一、半导体照明应用市场突破分析
- 二、单芯片市场竞争分析
- 三、太阳能光伏市场竞争分析

第三节 2016-2019年我国半导体材料企业竞争分析

- 一、国内硅材料企业竞争分析
- 二、政企联动竞争分析

第十一章 中国半导体材料主要生产商竞争性财务数据分析

第一节 有研半导体材料股份有限公司

- 一、企业概况
- 二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第二节 天津中环半导体股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第三节 宁波康强电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第四节 南京华东电子信息科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业成长性分析

四、企业经营能力分析

五、企业盈利能力及偿债能力分析

第五节 峨眉半导体材料厂

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第六节 洛阳中硅高科有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第七节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

一、企业基本概况

二、企业收入及盈利指标表

三、企业资产及负债情况分析

四、企业成本费用情况

第八节 北京中科镓英半导体有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业收入及盈利指标表
- 三、企业资产及负债情况分析
- 四、企业成本费用情况

第九节 上海九晶电子材料有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业收入及盈利指标表
- 三、企业资产及负债情况分析
- 四、企业成本费用情况

第十节 东莞钛升半导体材料有限公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业收入及盈利指标表
- 三、企业资产及负债情况分析
- 四、企业成本费用情况

第十一节 河南新乡华丹电子有限责任公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业收入及盈利指标表
- 三、企业资产及负债情况分析
- 四、企业成本费用情况

第十二章 2019-2025年中国半导体材料行业发展趋势分析

第一节 2019-2025年中国半导体材料行业市场趋势

- 一、2019-2025年国产设备市场调研
- 二、市场低迷创新机遇分析
- 三、半导体材料产业整合

第二节 2019-2025年中国半导体行业市场发展预测分析

- 一、全球光通信市场发展预测分析
- 二、化合物半导体衬底市场发展预测分析

第三节 2019-2025年中国半导体市场销售额预测分析

第四节 2019-2025年中国半导体产业预测分析

- 一、半导体电子设备产业发展预测分析
- 二、GPS芯片产量预测分析
- 三、高性能半导体模拟器件的发展预测

第十三章 2019-2025年中国半导体材料行业投资

图表 32 GAAS单晶生产方法比较

图表 33 世界GAAS单晶主要生产厂家

图表 34 SIC器件的研究概表

图表 35 现代微电子工业对硅片关键参数的要求

图表 36 多晶硅质量指标

图表 37 2016-2019年中国半导体分立器件制造企业数量增长趋势图

图表详见报告正文..... (GY YX)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国IC（半导体）市场分析报告-行业运营态势与发展前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的

发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/456118456118.html>